

**Väikesulavkaitsmed. Osa 4: Universaalsed
moodulsulavpanused**

Miniature fuses - Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)

This document is a preview generated by EVS

EESTI STANDARDI EESSÕNA

NATIONAL FOREWORD

Käesolev Eesti standard EVS-EN 60127-4:2001 sisaldab Euroopa standardi EN 60127-4:1996 ingliskeelset teksti.

Standard on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 19.03.2001 käskkirjaga ja jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teatajas.

Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.

This Estonian standard EVS-EN 60127-4:2001 consists of the English text of the European standard EN 60127-4:1996.

This standard is ratified with the order of Estonian Centre for Standardisation dated 19.03.2001 and is endorsed with the notification published in the official bulletin of the Estonian national standardisation organisation.

The standard is available from Estonian standardisation organisation.

ICS 29.120.50

additional requirements, definitions, dimensions and construction, marking, standard ratings, standard sheets, test equipment, universal modular fuse-links (umf)

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee

Right to reproduce and distribute belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: 605 5050; E-mail: info@evs.ee

ICS 29.120.50

Descriptors: Universal modular fuse-links (UMF), definitions, additional requirements, standard ratings, marking, test equipment, dimensions and construction, standard sheets

English version

Miniature fuses
Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)
(IEC 127-4:1996)

Coupe-circuit miniatures
Partie 4: Éléments de remplacement
modulaires universels (UMF)
(CEI 127-4:1996)

Geräteschutzsicherungen
Teil 4: Welteinheitliche
Modular-Sicherungseinsätze (UMF)
(IEC 127-4:1996)

This European Standard was approved by CENELEC on 1996-10-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of document 32C/155/FDIS, future edition 2 of IEC 127-4, prepared by SC 32C, Miniature fuses, of IEC TC 32, Fuses, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 60127-4 on 1996-10-01.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 1997-07-01
- latest date by which the national standards conflicting with the EN have to be withdrawn (dow) 1997-07-01

For products which have complied with the relevant national standard before 1997-07-01, as shown by the manufacturer or by a certification body, this previous standard may continue to apply for production until 2002-07-01.

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.
In this standard, annex ZA is normative.
Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 127-4:1996 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification.

Preview generated by EVS

Annex ZA (normative)

**Normative references to international publications
with their corresponding European publications**

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

NOTE: When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 68-2-20	1979	Basic environmental testing procedures Part 2: Tests - Test T: Soldering	HD 323.2.20 S3 ¹⁾	1988
IEC 68-2-21	1983	Part 2: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices	HD 323.2.21 S3 ²⁾	1988
IEC 68-2-58	1989	Part 2: Tests - Test Td: Solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of Surface Mounting Devices (SMD)	HD 323.2.58 S1	1991
IEC 115-1	1982	Fixed resistors for use in electronic equipment Part 1: Generic specification	-	-
A2	1987		-	-
A3	1989		-	-
A4	1993		-	-
IEC 115-8	1989	Part 8: Sectional specification: Fixed chip resistors	-	-
IEC 127-1	1988	Miniature fuses Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links	EN 60127-1 ³⁾	1991
IEC 194	1988	Terms and definitions for printed circuits	HD 142 S3	1991

1) HD 323.2.20 S3 includes A2:1987 to IEC 68-2-20.

2) HD 323.2.21 S3 includes A1:1985 to IEC 68-2-21.

3) EN 60127-1 includes the corrigendum March 1990 to IEC 127-1.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 249-2-5	1987	Base materials for printed circuits Part 2: Specifications Specification No. 5: Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical burning test)	EN 60249-2-5 ⁴⁾ + corr. March	1994 1994
IEC 326-3	1991	Printed boards Part 3: Design and use of printed boards	-	-
IEC 664-1 (mod)	1992	Insulation coordination for equipment within low-voltage systems Part 1: Principles, requirements and tests	HD 625.1 S1	1996
ISO 3	1973	Preferred numbers - Series of preferred numbers	-	-

4) EN 60249-2-5 includes A2:1992 to IEC 249-2-5.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

127-4

Deuxième édition
Second edition
1996-08

Coupe-circuit miniatures –

**Partie 4:
Éléments de remplacement modulaires universels
(UMF)**

Miniature fuses –

**Part 4:
Universal Modular Fuse-links (UMF)**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 127-4: 1996

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60 000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60 000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

127-4

Deuxième édition
Second edition
1996-08

Coupe-circuit miniatures –

**Partie 4:
Éléments de remplacement modulaires universels
(UMF)**

Miniature fuses –

**Part 4:
Universal Modular Fuse-links (UMF)**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

U

● Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	6

SECTION 1: PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES ET ÉQUIPEMENTS D'ESSAI

Articles

1	Domaine d'application et objet	8
2	Références normatives	8
3	Définitions	10
4	Prescriptions générales	10
5	Valeurs assignées	10
6	Marquage	12
7	Généralités sur les essais.....	12
8	Dimensions et construction.....	16
9	Prescriptions d'ordre électrique.....	22

Tableaux

1	Programme des essais pour éléments de remplacement	30
2	Valeurs maximales pour la chute de tension et la puissance dissipée	34

Figures

1	Symbole unique d'identification pour les UMFs.....	36
2	Carte d'essai à circuit imprimé pour éléments de remplacement de type à montage par trous.....	38
3	Carte d'essai à circuit imprimé pour éléments de remplacement de type à montage en surface	40
4	Socle d'essai	42
5	Dispositif de flexion pour éléments de remplacement de type à montage en surface ..	44
6	Circuit d'essai pour les essais du pouvoir de coupure.....	46

SECTION 2: FEUILLES DE NORME PARTICULIÈRES

Feuille de norme 1 – Éléments de remplacement de type à montage par trous

Feuille de norme 2 – Éléments de remplacement de type à montage en surface

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
INTRODUCTION	7
SECTION 1: ADDITIONAL REQUIREMENTS AND TEST EQUIPMENT	
Clause	
1 Scope and object	9
2 Normative references	9
3 Definitions	11
4 General requirements	11
5 Standard ratings	11
6 Marking	13
7 General notes on tests	13
8 Dimensions and construction	17
9 Electrical requirements	23
Tables	
1 Testing schedule for fuse-links	31
2 Maximum values of voltage drop and sustained dissipation	35
Figures	
1 Unique identifying symbol for UMFs	37
2 Test board for through-hole fuse-links	39
3 Test board for surface mount fuse-links	41
4 Test fuse base	43
5 Bending jig for surface mount fuse-links	45
6 Test circuit for breaking capacity tests	47

SECTION 2: STANDARD SHEETS

Standard sheet 1 – Through-hole fuse-links

Standard sheet 2 – Surface mount fuse-links

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COUPE-CIRCUIT MINIATURES –

Partie 4: Éléments de remplacement modulaires universels (UMF)

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 127-4 a été établie par le sous-comité 32C: Coupe-circuit à fusibles miniatures, du comité d'études 32 de la CEI: Coupe-circuit à fusibles.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue comme Document d'Orientation Technique (DOT) en 1989. Elle constitue, par conséquent, une révision technique qui conduit au statut de Norme internationale.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
32C/155/FDIS	32C/166/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MINIATURE FUSES –

Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 127-4 has been prepared by sub-committee 32C: Miniature fuses, of IEC technical committee 32: Fuses.

This second edition cancels and replaces the first edition, which was issued as a Technical Trend Document (TTD) in 1989. It constitutes therefore a technical revision and now has the status of an International Standard.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
32C/155/FDIS	32C/166/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

INTRODUCTION

La tendance à la miniaturisation des équipements électroniques a conduit les utilisateurs à prescrire des éléments de remplacement de petites dimensions et de conception appropriée pour les circuits imprimés ou les autres systèmes de substrats, si possible avec des moyens automatiques. Il est recommandé que ces éléments de remplacement soient conçus pour incorporer un degré de non-interchangeabilité.

Les tensions assignées de 32 V, 63 V, 125 V et 250 V sont toutes spécifiées pour les caractéristiques suivantes: la fusion très rapide (FF), la fusion rapide (F), la fusion retardée (T) et la fusion très retardée (TT).

En raison de l'importance croissante de la limitation des surtensions transitoires dans la nouvelle technologie, des recommandations sont incluses pour les limites des surtensions produites par ces fusibles dans des conditions d'essai spécifiées relatives aux configurations typiques des circuits.

Le choix est donné de spécifier le pouvoir de coupure en courant alternatif ou en courant continu. Il est considéré que les fusibles satisfaisant les prescriptions en courant continu les satisfont également en courant alternatif; cependant, des essais sont requis pour les valider. Les fusibles peuvent avoir deux caractéristiques assignées, dans ce cas, il convient que la documentation du constructeur y fasse référence.

Les utilisateurs de coupe-circuit miniatures expriment le voeu de n'avoir à considérer qu'un seul numéro de publication pour toutes les normes, recommandations et autres documents concernant les coupe-circuit miniatures, afin de faciliter tout renvoi aux coupe-circuit à fusibles dans d'autres spécifications, par exemple celles relatives aux équipements.

De plus, un seul numéro de publication et une subdivision en parties faciliteront la mise en oeuvre de nouvelles normes, car les articles et paragraphes comprenant des prescriptions générales n'auront pas à être répétés.

La nouvelle série de la CEI 127 est donc subdivisée comme suit:

CEI 127: Coupe-circuit miniatures (titre général)

CEI 127-1, Partie 1: Définitions pour coupe-circuit miniatures et prescriptions générales pour éléments de remplacement miniatures

CEI 127-2, Partie 2: Cartouches

CEI 127-3, Partie 3: Eléments de remplacement subminiatures

CEI 127-4, Partie 4: Eléments de remplacement modulaires universels (UMF)

CEI 127-5, Partie 5: Directives pour l'évaluation de la qualité des éléments de remplacement miniatures

CEI 127-6, Partie 6: Ensembles-porteurs pour éléments de remplacement miniatures

CEI 127-7: (Libre pour d'autres documents)

CEI 127-8: (Libre pour d'autres documents)

CEI 127-9, Partie 9: Ensembles-porteurs d'essai et circuits d'essai

CEI 127-10, Partie 10: Guide d'application

La quatrième partie de la présente norme concerne des prescriptions supplémentaires, des équipements d'essai et des feuilles de norme pour les UMFs.

Il est recommandé de la lire conjointement avec d'autres parties de la série de la CEI 127.

INTRODUCTION

The trend towards miniaturization of electronic equipment has caused users to require fuse-links of small dimensions, and of appropriate design for application to printed circuit boards or other substrate systems, possibly by automatic means. These fuse-links should be designed to incorporate a degree of non-interchangeability.

Rated voltages of 32 V, 63 V, 125 V, and 250 V are specified together with the following characteristics: very quick acting (FF), quick acting (F), time-lag (T) and long time-lag (TT).

Because of the increasing importance of limitation of transient overvoltages in new technology, recommendations are included for limits to the overvoltages produced by these fuses under specified test conditions related to typical circuit configurations.

The option is given to specify the breaking capacity with alternating current or direct current; it is considered that fuses that meet the d.c. requirement will meet the a.c. requirement; however, testing is required to validate this. Fuses may be dual rated, in which case the manufacturer's literature should be referred to.

The users of miniature fuses express the wish that all standards, recommendations and other documents relating to miniature fuses should have the same publication number in order to facilitate reference to fuses in other specifications, for example, equipment specifications.

Furthermore, a single publication number and subdivision into parts would facilitate the establishment of new standards, because clauses and subclauses containing general requirements need not be repeated.

The new IEC 127 series is thus subdivided as follows:

IEC 127: Miniature fuses (general title)

IEC 127-1, Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links

IEC 127-2, Part 2: Cartridge fuse-links

IEC 127-3, Part 3: Sub-miniature fuse-links

IEC 127-4, Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)

IEC 127-5, Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links

IEC 127-6, Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links

IEC 127-7: (Free for further documents)

IEC 127-8: (Free for further documents)

IEC 127-9, Part 9: Test-holders and test-circuits

IEC 127-10, Part 10: User guide

The fourth part of this standard covers additional requirements, test equipment and standard sheets for UMFs.

It should be read in conjunction with other parts of the IEC 127 series.

COUPE-CIRCUIT MINIATURES –

Partie 4: Éléments de remplacement modulaires universels (UMF)

SECTION 1: PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES ET ÉQUIPEMENTS D'ESSAI

1 Domaine d'application et objet

1.1 La présente partie de la CEI 127 s'applique aux éléments de remplacement modulaires universels (UMF) conçus pour le montage sur circuit imprimé et autres substrats, et employés pour la protection d'appareils électriques, de matériels électroniques et de leurs éléments constituants, normalement utilisés à l'intérieur.

Elle n'est pas applicable aux éléments de remplacement pour les appareils destinés à être employés dans des conditions particulières, telles que des atmosphères corrosives ou explosives.

Ces coupe-circuit sont normalement destinés à être montés ou remplacés uniquement par des personnes qualifiées, en utilisant des outils spéciaux.

Les éléments de remplacement pour utilisation dans les ensembles-porteurs sont à l'étude.

La présente norme renvoie en outre aux prescriptions de la CEI 127-1.

1.2 L'objet de cette partie de la CEI 127 est tel que donné dans la CEI 127-1, avec la prescription supplémentaire d'un degré de non-interchangeabilité.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 127. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 127 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 68-2-20: 1979, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais - Essai T: Soudure*

CEI 68-2-21: 1983, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation*

CEI 68-2-58: 1989, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Td: Soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de soudage des composants pour montage en surface (CMS)*

CEI 115-1: 1982, *Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques – Première partie: Spécification générique*

Modification 2 (1987)

Modification 3 (1989)

Amendement 4 (1993)

MINIATURE FUSES –

Part 4: Universal Modular Fuse-links (UMF)

SECTION 1: ADDITIONAL REQUIREMENTS AND TEST EQUIPMENT

1 Scope and object

1.1 This part of IEC 127 relates to Universal Modular Fuse-links (UMF) for printed circuits and other substrate systems, used for the protection of electric appliances, electronic equipment, and component parts thereof, normally intended to be used indoors.

It does not apply to fuse-links for appliances intended to be used under special conditions, such as in a corrosive or explosive atmosphere.

These fuses are normally intended to be mounted or replaced only by appropriately skilled persons using specialized equipment.

Fuse-links for use in fuse-holders are under consideration.

This standard applies in addition to the requirements of IEC 127-1.

1.2 The objects of this part of IEC 127 are as given in IEC 127-1, with the additional requirement of a degree of non-interchangeability.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 127. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision and parties to agreements based on this part of IEC 127 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68-2-20: 1979, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test T: Soldering*

IEC 68-2-21: 1983, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

IEC 68-2-58: 1989, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Td: Solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of Surface Mounting Devices (SMD)*

IEC 115-1: 1982, *Fixed resistors for use in electronic equipment – Part 1: Generic specification*

Amendment 2 (1987)

Amendment 3 (1989)

Amendment 4 (1993)

CEI 115-8: 1989, *Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques – Huitième partie: Spécification intermédiaire: Résistances fixes chipsets*

CEI 127-1: 1988, *Coupe-circuit miniatures – Partie 1: Définitions pour coupe-circuit miniatures et prescriptions générales pour éléments de remplacement miniatures*

CEI 194: 1988, *Termes et définitions concernant les circuits imprimés*

CEI 249-2-5: 1987, *Matériaux de base pour circuits imprimés – Deuxième partie: Spécifications – Spécification n° 5: Feuille de tissu de verre époxyde recouverte de cuivre, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale)*

CEI 326-3: 1991, *Cartes imprimées – Partie 3: Etudes et application des cartes imprimées*

CEI 664-1: 1992, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais*

ISO 3: 1973, *Nombres normaux – Séries de nombres normaux*

3 Définitions

Les définitions données à l'article 3 de la CEI 127-1 s'appliquent pour les besoins de la présente partie de la CEI 127 avec le complément suivant:

3.7.1 élément de remplacement de type à montage par trous: Un élément de remplacement de type à montage par trous est un élément de remplacement modulaire universel (UMF) conçu pour le montage direct sur des circuits imprimés par soudage, les sorties étant insérées dans des trous conçus pour un tel montage.

3.7.2 élément de remplacement de type à montage en surface: Un élément de remplacement de type à montage en surface est un élément de remplacement modulaire universel (UMF) conçu pour la fixation conductrice directe sur la surface d'un substrat par soudage ou d'autres méthodes, sans que les sorties soient insérées dans des trous ou socles conçus pour un tel montage.

3.28 pastille: Une pastille est une partie d'impression conductrice utilisée usuellement – mais non exclusivement – pour la connexion et/ou la fixation des composants (voir CEI 194).

NOTE – D'autres définitions applicables pour l'utilisation des éléments de remplacement de type à montage en surface peuvent être trouvées dans la CEI 115-1 et la CEI 115-8.

4 Prescriptions générales (voir CEI 127-1)

5 Valeurs assignées

5.1 Tension assignée

Voir les feuilles de norme particulières.

IEC 115-8: 1989, *Fixed resistors for use in electronic equipment – Part 8: Sectional specification: Fixed chip resistors*

IEC 127-1: 1988, *Miniature fuses – Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links*

IEC 194: 1988, *Terms and definitions for printed circuits*

IEC 249-2-5: 1987, *Base materials for printed circuits – Part 2: Specifications – Specification No. 5: Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet, of defined flammability (vertical burning test)*

IEC 326-3: 1991, *Printed boards – Part 3: Design and use of printed boards*

IEC 664-1: 1992, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

ISO 3: 1973, *Preferred numbers – Series of preferred numbers*

3 Definitions

The definitions given in clause 3 of IEC 127-1 apply for the purpose of this part of IEC 127, with the addition of the following:

3.7.1 through-hole fuse-link: A through-hole fuse-link is a UMF designed for soldering directly into a printed wiring board, with insertion of its leads in suitably designed holes.

3.7.2 surface mount fuse-link: A surface mount fuse-link is a UMF designed for direct conductive attachment by solder or other means on to the surface of a substrate, without insertion of its leads in suitably designed holes or sockets.

3.28 land: Portion of a conductive pattern usually but not exclusively used for the connection and/or attachment of components (see IEC 194).

NOTE – Further definitions which may be useful in the application of surface mount fuse-links may be found in IEC 115-1 and IEC 115-8.

4 General requirements (see IEC 127-1)

5 Standard ratings

5.1 Rated voltage

See standard sheets.